

# ITER ダイバータ不純物モニター分光器用 光学素子の照射試験用試料の製作

## 仕 様 書

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構  
那珂フュージョン科学技術研究所  
ITER プロジェクト部 計測開発グループ

## 目次

1	一般仕様	2
1.1	件名	2
1.2	目的及び概要	2
1.3	契約範囲	2
1.4	納期	2
1.5	納入場所及び納入条件	2
1.6	納入物	2
1.7	検査条件	2
1.8	提出図書	2
1.9	品質管理	3
1.10	情報セキュリティの確保	3
1.11	知的財産権及び技術情報等の取扱い	3
1.12	グリーン購入法の推進	3
1.13	適用法規・規格等	3
1.14	協議	3
2.	技術仕様	4
2.1	製作仕様	4
2.2	検査に関する仕様	6
2.2.1	一般検査に関する仕様	7
2.2.2	光学検査に関する仕様	7
2.3	提出図書の作成	7
別添-1	『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』	9
別添-2	知的財産権特約条項	10

# 1 一般仕様

## 1.1 件名

ITER ダイバータ不純物モニター分光器用光学素子の照射試験用試料の製作

## 1.2 目的及び概要

本件では、ITER ダイバータ不純物モニター(DIM)の分光器での使用を想定している光学素子に関して、従来品に比べ反射と透過の切替え波長領域が狭い分光透過率を有するダイクロミックミラーと誘電体多層膜を用いた高反射率を有するミラー及び狭帯域バンドパスフィルターの照射試験用試料の製作を行い、DIM の調達活動に資することを目的とする。

## 1.3 契約範囲

- (1) 1.6 項に示す納入物の納入 1 式
- (2) 2.2 項に示す製作物の検査 1 式

## 1.4 納期

令和 7 年 11 月 28 日

## 1.5 納入場所及び納入条件

- (1) 納入場所  
茨城県那珂市向山 8 0 1 - 1  
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「QST」という）  
那珂フュージョン科学技術研究所 ITER 研究開発棟 2 階 R235
- (2) 納入条件  
持込渡し又は宅配便等による配送（配送料は受注者負担）

## 1.6 納入物

- (1) 1.8 項に定める提出図書 1 式
- (2) ダイクロミックミラー 1 種 10 枚 計 10 枚
- (3) 誘電体多層膜ミラー 1 種 10 枚 計 10 枚
- (4) 狭帯域バンドパスフィルター 3 種各 10 枚 計 30 枚

## 1.7 検査条件

1.6 項に示す納入物の完納及び 2.2 項に示す試験検査が合格したことを QST が確認したときをもって検査合格とする。

## 1.8 提出図書

下表に示す図書を提出すること。

No.	図書名	提出時期	部数	確認
1	作業工程表	契約締結後速やかに	1 部	不要
2	打合せ議事録	打合せ後 1 週間以内	1 部	不要
3	設計計算書	製作開始前	1 部	要
4	製作確認図	製作開始前	1 部	要
5	検査要領書	試験検査実施 1 週間前まで	1 部	要
6	検査成績書	納期まで	1 部	不要
7	再委託承諾願 (QST 指定様式)	再委託先による作業開始の 2 週間前まで ※再委託等がある場合に紙媒体にて提出	1 部	要

提出図書は、紙媒体の他、電子メール又は QST のオンラインストレージシステムによって提出すること。提出図書の詳細内容は、協議の上決定される。

(提出図書の確認方法)

QST は確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは受理したものとする。

ただし、再委託承諾願については紙媒体での提出後に QST が確認し、書面で回答する。

## 1.9 品質管理

受注者は、本契約に係る製作及び試験検査の工程において十分な品質管理を行うこととする。

### 1.10 情報セキュリティの確保

情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。

### 1.11 知的財産権及び技術情報等の取扱い

#### (1) 知的財産権等の取扱い

知的財産権等の取扱いについては別添-2『知的財産権特約条項』に示すとおりとする。

#### (2) 技術情報

受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面による QST の承認を得なければならない。

QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QST と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償で QST に提供すること。

#### (3) 成果の公開

受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面による QST の承認を得なければならない。

### 1.12 グリーン購入法の推進

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に適用する環境物品（事務用品、OA 機器等）が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

### 1.13 適用法規・規格等

日本産業規格（JIS）もしくは米軍 MIL 規格（United States Military Standard）、別途独自規格を適用する場合は、設計計算書及び検査要領書にその詳細を記載すること。

### 1.14 協議

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QST と協議の上、その決定に従うものとする。

## 2. 技術仕様

2.1 項に製作物の仕様を示す。

製作開始前に設計計算書及び製作確認図を作成し、QST の確認を得てから製作を実施すること。

製作物に対する試験検査の仕様を 2.2 項、提出図書の作成に関する仕様を 2.3 項にそれぞれ示す。

### 2.1 製作仕様

本件では、表 1 から表 5 に示す仕様の 5 種 (A30K、MIR\_1、BPF\_uv313.1、BPF\_uv372.1、BPF\_uv400.80) の平行平面板の光学素子 (ダイクロイックミラーと誘電体多層膜ミラー及びバンドパスフィルター) を製作すること。

表 1 ダイクロイックミラー A30K の要求仕様

項目	仕様
基板材料	合成石英 (屈折率データを添付すること)
直径	φ 25.4mm ± 0.1 mm
厚み	2.0mm 0.0/-0.1mm
有効径	φ 23mm 以上
透過率 (T)、反射率 (R) 規格	T=50%にて 355 ± 5nm (R) 250 ~ 350nm にて 85%以上 (T) 360 ~ 440nm にて 85%以上
入射角	30°
S/D スクラッチディグ	60 / 40
員数	10 枚

表 2 誘電体多層膜ミラー MIR\_1 の要求仕様

項目	仕様
基板材料	合成石英
直径	φ 25.4mm ± 0.1 mm
厚み	2.0mm ± 0.1mm
有効径	φ 23mm 以上
反射率 (R) 規格	250 ~ 400nm R > 92%以上 95%以上 (目標) 400 ~ 1000nm R > 95%以上 97%以上 (目標)
入射角	0 ~ 15°
S/D スクラッチディグ	60 / 40
員数	10 枚

表 3 バンドパスフィルター BPF\_uv313.1 の要求仕様

項目	仕様
基板材料	合成石英 (屈折率データを添付すること)
直径	$\phi 25.4 \pm 0.1 \text{ mm}$
厚み	$2.0 \pm 0.1 \text{ mm}$
有効径	$\phi 23 \text{ mm}$ 以上
透過率 (T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 観測波長(<math>\lambda</math>) 313.1nm にて 80%以上</li> <li>・ 284.6~298.9nm 及び 327.3~341.6 にて 1%以下</li> <li>・ 200~284.6nm 及び 341.6~440nm にて 0.1%以下</li> </ul>
半値幅 (又は透過率 50%幅)	5.0nm 以下
入射角	0°
S/D スクラッチディグ	60 / 40
員数	10 枚

表 4 バンドパスフィルター BPF\_uv372.1 の要求仕様

項目	仕様
基板材料	合成石英 (屈折率データを添付すること)
直径	$\phi 25.4 \pm 0.1 \text{ mm}$
厚み	$2.0 \pm 0.1 \text{ mm}$
有効径	$\phi 23 \text{ mm}$ 以上
透過率 (T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 観測波長(<math>\lambda</math>) 372.1nm にて 85%以上</li> <li>・ 358~365.1nm 及び 379.1~386.2nm にて 1%以下</li> <li>・ 200~358nm 及び 386.2~440nm にて 0.1%以下</li> </ul>
半値幅 (又は透過率 50%幅)	3.3nm 以下
入射角	0°
S/D スクラッチディグ	60 / 40
員数	10 枚

表 5 バンドパスフィルター BPF\_uv400.80 の要求仕様

項目	仕様
基板材料	合成石英 (屈折率データを添付すること)
直径	$\phi 25.4 \pm 0.1 \text{ mm}$
厚み	$2.0 \pm 0.1 \text{ mm}$

有効径	φ 23mm 以上
透過率 (T)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 観測波長(λ) 400.80nm にて 87%以上</li> <li>・ 393.6~397.2nm 及び 404.5~408.1nm にて 1%以下</li> <li>・ 200~393.6nm 及び 408.2~440nm にて 0.1%以下</li> </ul>
半値幅 (又は透過率 50%幅)	1.0nm 以下 (目標 0.8nm 以下)
入射角	0°
S/D スクラッチディグ	60 / 40
員数	10 枚

## その他仕様

- 測定 : 員数全てにおいて現物での測定を行うことを基本とする。短波長側の測定においては、ダイクロイックミラーと誘電体多層膜ミラーは 220nm までの測定を行うこととし、200nm までの値は設計計算書にシミュレーションの値を記入することとする。バンドパスフィルターは 200nm まで測定を行うこと。ただし、正確と見られない測定結果が表示される領域は設計計算書にシミュレーションの値を記入することとする。A30K にて、主光線の入射角 30°、光線の広がり角 (半角) 6.9° での測定を 1 個以上行うこと。MIR\_1 に関しては、0° (垂直入射反射) に対して 15° までの角度にて測定装置に都合の良い角度での測定とする。バンドパスフィルター3種に関しては 0° での入射角度を規格として透過率測定を実施し、2° での測定も行うこととする。誘電体多層膜ミラーとダイクロイックミラーは、ランダム偏光入射、P 偏光入射、S 偏光入射それぞれでの測定結果を検査成績書に記載すること。
- 裏面側面 : 裏面利用時に仕様を満足させる膜ではない場合は、AR コート (反射防止) を施し、側面粗ざり部に「<」などの刻字またはマーキングを行い、表裏面の区別を行うこととする。  
表面への製膜により、表 1 から表 5 に示す反射率及び透過率を得られる場合は裏面側面に何かを施す必要はない。
- 面精度 : 両面成膜後、λ/4 (目標) 以下とし、測定できるものの成膜後実測を行うこと。測定不可の場合は、基板状態での面精度保証とし、その精度維持のため中間層を設ける等のソリ対策を実施すること。  
なお、上記λは観測波長での値が好ましい。
- スクラッチディグ : MIL-13830B 規格相当以上であること。なお、別途、独自規格を採用する場合は、事前に QST と協議の上了承を得ること。

## 2.2 検査に関する仕様

2.2.1 項及び 2.2.2 項に示す検査を行うこと。

なお、検査実施 1 週間前までに QST へ検査要領書を提出し、QST の承認を得てから検査を実施すること。実施した測定結果を検査成績書にて提出すること。

### 2.2.1 一般検査に関する仕様

以下の一般検査を実施し、結果を検査成績書に記載すること。

- ① 外観検査：製作物の外観を目視検査し、有害な傷が無いことを確認すること。
- ② 員数検査：2.1 項に示した員数と一致することを確認すること。
- ③ 寸法検査：製作物の寸法が公差以内であることを確認すること。
- ④ 薄膜の耐久性検査：2.1 項で示した製作物(納品物)と同様仕様のテストピースを作成し、以下の検査 (MIL-C-48497A 等参照) を行うこと (テストピースは納入不要)。各試験後に剥離等の痕跡、クラックまたは膨れがあるものは不可とする。また、実施方法などは QST との事前協議で修正できるものとする。

膜硬度試験 ----木綿布を厚さ6.4mm に折り重ね幅9.5mm で荷重454gをかけて25サイクル摩擦すること。

膜密着性試験 ---セロハンテープ (ニチバン製) を成膜面に押し付け、垂直方向に素早く引き剥がすこと。また、膜の剥離が無きこと。

耐湿性試験 --- 温度 49°C湿度 95~100%の雰囲気にて 24 時間さらすこと。

耐溶剤性 -----アセトン、エタノール等の一般溶剤で表面を拭き、剥がれ クラック、クモリ、ムラ等の異常が無きこと。

### 2.2.2 光学検査に関する仕様

- ・ダイクロイックミラーの分光透過率及び分光反射率、誘電体多層膜ミラーの分光反射率、バンドパスフィルターの分光透過率をそれぞれ測定し、2.1 項で定めた仕様を満たしていることを全数測定確認すること。
- ・ダイクロイックミラーの実測データ等に関しては、入射角 30° での反射率 (R) 及び透過率 (T) 実測定データを検査成績書へ記載すること。ただし、透過率 (T) に関しては 30±6.9° (もしくは準ずる角度) での測定も実施すること (個数限定で可)。裏面の AR コートに関しても可能な限り実測数値を検査成績書へ記載すること。
- ・誘電体多層膜ミラーの実測データ等に関しては、入射角 0~15° の間で測定装置都合等にて測定角度を決定し、反射率 (R) 全数実測定データを検査成績書へ記載すること。
- ・各バンドパスフィルターの透過率 (裏面コート含む) を測定し、2.1 項で定めた仕様に対する差を確認すること。透過率実測データ等に関しては、入射角 0° 及び 2° での実測定データを検査成績書へ記載すること。なお、観測波長以外の領域における透過率数値が仕様の値を超えた場合は、QST との協議にて合否を決定する。

### 2.3 提出図書の作成

- ・作業工程表は、設計・製作・検査の作業実施時期が分かるように記述すること。また、必要に応じて各項の作業を細分化すること。
- ・打合せ議事録には、協議した項目のみでなく決定事項及び必要な行動と担当者、その期限を記載すること。
- ・設計計算書では、コンピュータプログラム等による 2.1 項で定めた仕様を満足する成膜設計を行った結果として、分光透過率及び分光反射率の計算値をグラフとして示すこと。また、グラフに対応する数値データを Microsoft Excel 形式 (もしくは csv 形式) の電子ファイルと

して提出すること。

- ・製作確認図は、寸法、公差、材料、員数、規格などが分かるように作図すること。
- ・検査要領書には、以下の内容を含めること。
  - (1) 使用する測定器
  - (2) 検査の判定基準
- ・検査成績書には、以下の内容を含めること。
  - (1) 使用した測定器等
  - (2) 検査結果及び検査要領書で定めた判定基準との対比

以上

## 別添-1

### 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』

- 1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム（情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。）を利用する場合には、QST の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。
- 2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、QST の情報セキュリティ確保のために、QST が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
  - (1) 受注者は、契約の業務に携わる者（以下「業務担当者」という。）を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。
  - (2) 受注者は、契約に関して知り得た情報（QST に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。）を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。
  - (3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。
  - (4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア（Winny、WinMX、KaZaa、Share 等）及び SoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。
  - (5) 受注者は、QST の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を QST 又は受注者の情報システム 以外の情報システム（業務担当者が所有するパソコン等）において取り扱ってはならない。
  - (6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、QST に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  - (7) 受注者は、QST が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。
  - (8) 受注者は、QST の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに QST に報告し、QST の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。

なお、QST の入札に参加する場合、又は QST からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。

以上

## 別添一2 知的財産権特約条項

(知的財産権等の定義)

第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。

- 一 特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権、実用新案法（昭和34年法律第123号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和34年法律第125号）に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和60年法律第43号）に規定する回路配置利用権、種苗法（平成10年法律第83号）に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利（以下総称して「産業財産権等」という。）
  - 二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
  - 三 著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する著作権（著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。）及び外国における著作権に相当する権利（以下総称して「著作権」という。）
  - 四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの（以下「ノウハウ」という。）を使用する権利
- 2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
- 一 特許権の対象となるものについてはその発明
  - 二 実用新案権の対象となるものについてはその考案
  - 三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出
- 3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。

(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)

第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等を行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

- 一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。
- 二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理

由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。

三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。

四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権（仮専用実施権を含む。）若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾（以下「専用実施権等の設定等」という。）をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。

イ 子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう。以下同じ。）又は親会社（会社法第 2 条第 4 号に規定する親会社をいう。

以下同じ。）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合

ロ 承認 T L O（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成 10 年法律第 52 号）第 4 条第 1 項の承認を受けた者（同法第 5 条第 1 項の変更の承認を受けた者を含む。）又は認定 T L O（同法第 11 条第 1 項の認定を受けた者）に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合

ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合

2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。

3 乙は、第 1 項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。

（知的財産権の報告）

第 3 条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。

2 乙は、産業技術力強化法（平成 12 年法律第 44 号）第 17 条第 1 項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則（昭和 35 年通商産業省令第 10 号）実用新案法施行規則（昭和 35 年通商産業省令第 11 号）及び意匠法施行規則（昭和 35 年通商産業省令第 12 号）等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない。

- 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内（ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
- 4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき（ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。）は、実施等した日から60日以内（ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
- 5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。

（乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転）

- 第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合（本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。）には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
- 2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハマまでに定める場合には、この限りでない。
  - 3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社（これらの会社が日本国外に存する場合に限る。）である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。
  - 4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内（ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
  - 5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。

（乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾）

- 第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
- 2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハマまでに定める場合は、この限りではない。
  - 3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社（これらの会社が日本国外に存する場合に限る。）である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。

- 4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内（ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内）に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
- 5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。

（乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄）

第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。

（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属）

第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。

- 一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
  - 二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する第三者に許諾する。
- 2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
- 3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。

（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転）

第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

（甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾）

第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)

第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。

2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的实施をするときは、甲が自ら商業的实施をしないことに鑑み、乙の商業的实施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。

(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)

第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。

(著作権の帰属)

第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。

2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。

3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。

(合併等又は買収の場合の報告等)

第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合（乙の親会社を変更した場合を含む。第3項第1号において同じ）は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。

2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。

3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。

一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。

二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。

三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。

(秘密の保持)

第 14 条 甲及び乙は、第 2 条及び第 7 条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。

(委任・下請負)

第 15 条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。

2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。

(協議)

第 16 条 第 2 条及び第 7 条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

(有効期間)

第 17 条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

以上